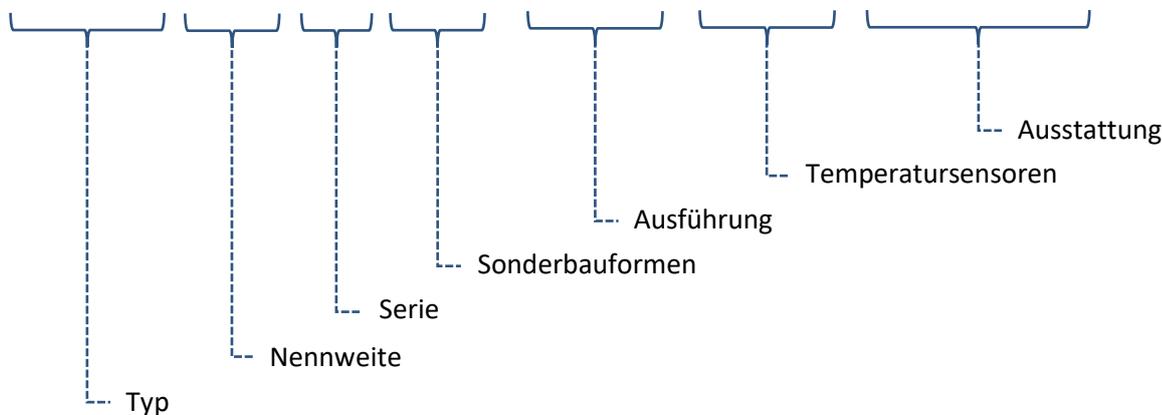


# VELCO 500 H2 N80 [KXGX-S1S18-XXX1DM]



## Typ und Nennweite - VELCO 500 H2 N80

Typ	
VELCO	≥ DN 250 / Generation 1
VELCO <sup>2</sup>	≥ DN 250 / Generation 2
VCP	≤ DN 200 / Kühlkopf 90° zu Flansch

Standard Nennweiten	
DN 100	DN 500
DN 160	DN 630
DN 200	DN 800
DN 250	DN 900
DN 320	DN 1000
DN 400	DN 1250

## Serie und Sonderbauform - VELCO 500 H2 N80 (Optional)

Serie	
<b>S</b>	Sputter Prozess mit Argon, T1 Limitierung (Memory-Effekt) und grosses Baffle für Prozessdrücke bis 5E-3mbar.
<b>Xe</b>	Für Prozesse mit Xenon, spezieller Aufbau ermöglicht das Pumpen von Xe bei <50K auf der 1. Stufe
<b>LN2</b>	Die erste Stufe wird mit flüssig Stickstoff betrieben. Die zweite mit einem GM-Kühlsystem.
<b>H2</b>	Optimiert für Wasserstoff als Prozessgas. Sonderbauformen für Saugvermögen und Saugleistung.
<b>LV</b>	Low Vibration. Puls-Tube Kühlsystem und weitere Massnahmen, um die Vibrationen zu minimieren.
<b>UHV</b>	Alles metallisch gedichtet und in verschiedenen Stufen ausheizbar für UHV-Anwendungen.
<b>Kr</b>	Für Prozesse mit Krypton, spezieller Aufbau ermöglicht das Pumpen von Kr bei <37K auf der 1. Stufe

Sonderbauform	
<b>N</b>	Ein oder zwei Buchstaben werden verwendet, um vom Standard abweichende Kühloptionen zu deklarieren.
<b>80</b>	Diese Zahl beschreibt die niedrigste Temperaturbeständigkeit der verwendeten Komponenten. (ohne Displacer)

## Produkteschlüssel VELCO und VCP

### Ausführung [KXGX-S1S18-XXX1DM]

Flansch	Gehäusematerial	Gehäusebauform	Chemische Beständigkeit
<b>K</b> ISO-K	<b>X</b> 1.4301	<b>G</b> Standard	<b>X</b> Standard
<b>F</b> ISO-F	<b>L</b> 1.4404	<b>F</b> Flansch ohne Gehäuse	<b>K</b> Korrosive Medien
<b>C</b> CF-F	<b>A</b> 3.2315	<b>C</b> Gehäuse alle Flansche CF gedichtet, Kühlkopf mit Kantendichtung	<b>R</b> Strahlung
<b>A</b> ASA		<b>O</b> Gehäuse alle Flansche CF gedichtet, Kühlkopf mit O-Ring	<b>T</b> Tritium
<b>V</b> Venyl		<b>U</b> Gehäuse alle Flansche CF gedichtet, Kühlkopf CF gedichtet	<b>M</b> Unempfindlich gegen metallische Beschichtung
		<b>W</b> Gehäuse mit Wasserkühlung und O-Ring gedichtet	<b>Y</b> T + Keine fluor und chlor haltige Bestandteile
		<b>Z</b> Gehäuse mit Wasserkühlung und CF gedichtet	

### Temperatursensoren [KXGX-S1S18-XXX1DM]

Typ Stufe 1	Anzahl	Typ Stufe 2	Anzahl	Durchführung
<b>X</b> Keine	<b>X</b>	<b>X</b> Keine	<b>X</b>	<b>5</b> 5-Pin CF-F Vacom
<b>S</b> KTS Standard	<b>1</b>	<b>S</b> KTS Standard	<b>1</b>	<b>8</b> 8-Pin ISO-K Lemo
<b>K</b> KTS Leicht korrosiv	<b>2</b>	<b>K</b> KTS Leicht korrosiv	<b>2</b>	<b>S</b> 5-Pin CF-F Sumitomo
<b>D</b> KTS Hoch korrosiv	<b>3</b>	<b>D</b> KTS Hoch korrosiv	<b>3</b>	
<b>P</b> KTP PT sensor	<b>4</b>	<b>P</b> KTP PT sensor	<b>4</b>	
<b>C</b> KTC Cernox vergossen		<b>C</b> KTC Cernox vergossen		
<b>Y</b> KTC Cernox offen		<b>Y</b> KTC Cernox offen		
<b>L</b> KTD Diode DT670		<b>L</b> KTD Diode DT670		
<b>U</b> Diode SI-410		<b>U</b> Diode SI-410		

### Ausstattung [KXGX-S1S18-XXX1DM]

Ventil	Spülgas	Heizung	Anz. HCH	Druckmessung	Elektronik
<b>X</b> Keine	<b>X</b> Keine	<b>X</b> Keine	<b>X</b>	<b>X</b> Keine	<b>X</b> Keine
<b>P</b> AVC 040	<b>V</b> N.C.	<b>H</b> Heizmanschette	<b>1</b>	<b>P</b> PKR 251	<b>T</b> TPM
<b>B</b> UHV GE41	<b>N</b> N.O.	<b>D</b> HDL	<b>2</b>	<b>T</b> PIT 104	<b>C</b> CBO
		<b>S</b> HDH		<b>D</b> 2x CCT 36x	<b>M</b> T + C
				<b>R</b> TPR 018	
				<b>G</b> PSG 500	
				<b>C</b> 2x CDG025	
				<b>H</b> CDG100D	